

FOSB/FOUP 洗浄装置「FOC300」を開発

芝浦メカトロニクス株式会社は、このたびウェーハの搬送容器である FOSB や FOUP を洗浄する装置「FOC300」を開発し、販売を開始しました。

半導体製造工程の微細化が進むことで従来以上にウェーハ搬送時における容器内の、パーティクル、吸着ガス、水分などの残留物による製品の歩留まりへの影響が懸念されています。

これらの対象物を除去することで、「製品の歩留まりを向上したい」、「洗浄の効果を見える化したい」という声を基に装置化を進めてきました。

FOC300 は 300mm ウェーハ対応の FOSB および FOUP に対し、当社独自の洗浄ツールや、出ガスや水分を効果的に除去する機能を搭載し、洗浄および乾燥に対して優れた性能を発揮します。

また、品質管理に役立てられるよう、各種検査機能をオプションにて用意しています。

□製品概要 FOSB/FOUP 洗浄装置 FOC300

□特 長

【優れた洗浄性能・乾燥性能】

- ・当社オリジナルの二流体ノズルを採用し、パーティクル除去率 95% 以上、アンモニア等の吸着ガス（AMC）除去率 80% 以上、従来比較（*1）で 5 倍以上を達成。

*1 当社実機および他社実機による性能比較

- ・ヒーターの配置最適化および、真空乾燥により、優れた乾燥性能を発揮。

【品質管理のための充実したオプション検査機能】

- ・廃水の液中パーティクル測定機能、ガス分析、湿度の検査機能、外観検査等、ウェーハを通じてのパーティクル確認とは別で、FOSB、FOUP のみで確認可能

【装置仕様】

- ・スループット 30 個／hr *レシピおよび装置構成による
- ・GEM300 の標準対応 オンライン通信や各種自動搬送対応
- ・SEMI, CE などの規格準拠



【お問い合わせ先】

芝浦メカトロニクス株式会社
ファインメカトロニクス事業部

<https://www.shibaura.co.jp/inquiry/index.html>